

Frore Systems 凭借 AirJet® 固态主动散热解决方案 助力 AI 性能提升



美国加州圣何塞——2025 年 1 月 2 日：Frore Systems 在 2024 年发布了一系列重要成就，展示了为何 AirJet——全球首款固态主动散热芯片，能够满足制造商对 AI 性能提升的需求。这家公司在 2024 年实现了多个客户与技术里程碑，成为行业的领军企业。

2024 年的重要成就

- **客户产品上市：**Frore Systems 宣布多款搭载 AirJet 散热解决方案的商业产品上市，包括迷你电脑、工业平板电脑、AI 边缘网关和专业 SSD 硬盘，这些产品在性能和功能上均实现了突破。此外，多家顶级制造商正在开发消费类、智能家居、智慧城市和工业产品，预计将于 2025 年陆续上市，其中部分产品将于 2025 年巴塞罗那的世界移动通信大会（Mobile World Congress）上亮相。Frore Systems 自 2024 年 1 月起已启动大规模出货，以满足市场需求。
- **新产品发布：**推出多款全新 AirJet 产品：
 - AirJet Mini Slim：更薄、更轻、更智能且功能更先进的固态主动散热芯片。
 - AirJet Mini Sport：防水版 AirJet 芯片，荣获多项大奖，首次实现对 IP68 防水设备的主动散热。

- AirJet PAK：全球首款即插即用、完全自动化的固态主动散热模块，可搭配多种 AI 计算模块使用，包括 NVIDIA Jetson Orin Nano、Nano Super、NX 和 AGX 模块，以及 Qualcomm、NXP 和 AMD/Xilinx 的模块。
- **获得多项行业大奖：**
 - CES® 2024 “最佳创新奖” 荣誉奖：AirJet Mini 在嵌入式技术类别中脱颖而出。
 - CES® 2024 创新奖：在电脑硬件与组件和嵌入式技术两大类别中获得表彰。
 - 未来存储技术峰会：荣获“最具创新技术奖”。
 - EE Times 亚洲金选奖：获得“新兴初创企业金选奖”。
- **通过 ISO 认证：**
 - 2024 年，Frore Systems 位于台湾的工厂通过了 ISO9001 和 ISO14001 认证，展现了公司在满足客户需求、高效生产以及环境保护方面的承诺。
- **通过严格的可靠性测试：**
 - AirJet 芯片通过了长时间连续运行和极端环境测试，包括跌落、震动、冲击、防尘、高湿度及高温测试，并成为多家顶级制造商的认可供应商。
- **完成 C 轮融资：**
 - 2024 年 5 月，Frore Systems 完成由 Fidelity Management & Research Company 领投的 8000 万美元 C 轮融资，总融资金额已超过 2 亿美元。资金将用于持续研发以及扩大生产规模，以满足对 AirJet 固态主动散热解决方案日益增长的市场需求。

CES 2025 现场展示：Frore Systems 将于 1 月 7 日至 10 日在拉斯维加斯威尼斯人展览中心 2 层 2401B 室，展示搭载 AirJet 芯片的多款商业产品及新设备，包括：Samsung Galaxy Book4 Edge 和 Apple iPad Pro：搭载 AirJet 后，性能提升 50%。NVIDIA Jetson Orin 边缘 AI 平台：使用 AirJet PAK 提升 AI 性能，实现超紧凑、静音、防震、防尘和防水的工业级外壳设计。

关于 Frore Systems

Frore Systems 开发突破性电子与消费设备热管理技术，其 AirJet 系列散热解决方案可实现静音、超薄、轻量、防震、防尘和防水的高性能产品。公司总部位于加州圣何塞，在台湾设有办公室及制造基地。欲了解更多信息，请访问 <https://froresystems.com/>

媒体联络：Sue Ryan – Frore Systems 市场副总裁

邮箱：sue@froresystems.com

电话：+1 314 914 5008